

Title (en)

HEAT-SEAL COATING USING DISPERSIONS.

Title (de)

HEISSIEGELBESCHICHTUNG AUF DISPERSIONSBASIS.

Title (fr)

REVETEMENTS POUR SCELLAGE A CHAUD A BASE DE DISPERSIONS.

Publication

EP 0612343 A1 19940831 (DE)

Application

EP 92923312 A 19921106

Priority

- DE 4137512 A 19911115
- EP 9202553 W 19921106

Abstract (en)

[origin: EP0542160A1] The invention relates to reactive systems for bonding and/or coating substrates over the entire surface, in particular for heat-seal coatings, based on aqueous dispersions, a resin (I) which can be cured by means of epoxides, and epoxide compounds as curing agent (II). The addition, as curable resin (Ia), of polyurethane polymers containing functional groups which are reactive towards epoxides allows blocking-resistant, heat-seal-coated substrates to be produced which can be further converted, for example for the production of flexible printed circuits.

Abstract (fr)

Il est décrit des systèmes réactionnels destinés à des connexions planes et/ou à des revêtements plans de substrats, notamment à des revêtements pour scellage à chaud, à base de dispersions aqueuses d'une résine durcissable aux époxydes (I) et de composés époxy comme durcisseurs (II). En utilisant comme résine durcissable (Ia) des polymères de polyuréthane à groupes fonctionnels réagissant vis-à-vis des époxydes, on peut fabriquer des substrats cohérents revêtus par scellage à chaud qui peuvent être utilisés, par exemple, pour la fabrication de circuits imprimés souples.

IPC 1-7

C09J 175/04; C09D 175/04; C09J 163/00; C09D 163/00; H01B 3/30

IPC 8 full level

C09D 163/00 (2006.01); **C08L 63/00** (2006.01); **C09D 175/00** (2006.01); **C09D 175/04** (2006.01); **C09J 163/00** (2006.01); **C09J 175/04** (2006.01); **H01B 3/30** (2006.01); **H05K 3/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)

C08L 63/00 (2013.01 - EP US); **C09D 175/04** (2013.01 - EP US); **C09J 175/04** (2013.01 - EP US); **C08G 2270/00** (2013.01 - EP US); **H05K 3/285** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 9310202A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0542160 A1 19930519; **EP 0542160 B1 19951227**; AT E132176 T1 19960115; BR 9206758 A 19951031; CA 2123610 A1 19930527; CA 2123610 C 20020702; DE 4137512 A1 19930519; DE 59204837 D1 19960208; DK 0542160 T3 19960520; EP 0612343 A1 19940831; ES 2082331 T3 19960316; GR 3019021 T3 19960531; JP 3794432 B2 20060705; JP H07501095 A 19950202; NO 308864 B1 20001106; NO 940735 D0 19940303; NO 940735 L 19940303; US 5464494 A 19951107; WO 9310202 A1 19930527

DOCDB simple family (application)

EP 92119076 A 19921106; AT 92119076 T 19921106; BR 9206758 A 19921106; CA 2123610 A 19921106; DE 4137512 A 19911115; DE 59204837 T 19921106; DK 92119076 T 19921106; EP 9202553 W 19921106; EP 92923312 A 19921106; ES 92119076 T 19921106; GR 960400423 T 19960220; JP 50893693 A 19921106; NO 940735 A 19940303; US 24075194 A 19940510